

スマートプロセス学会誌

目 次 Vol. 13 No. 5 2024 (令和 6 年 9 月)

Mate2024 特集号 一第30回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム

会 告	N19
卷 頭 言	Mate2024 特集号によせて 山内 啓.....	219
特 集		
研究論文	ワイドバンドギャップパワー半導体用 超小型パワーチップサイズパッケージの開発と評価・解析 高橋弘樹・鈴木慧太・喜多村明・遠藤哲郎・高橋良和.....	220
	チップレットで構成された高発熱マイクロプロセッサのための 熱抵抗低減に関する研究 西 剛伺.....	226
	PR パルス電解を用いたリードフレーム上の粒状硫酸銅めっき形成 中 亮太・吉川純二・石原隆雄・大野厚三.....	233
	異材界面の剥離予測手法を用いた半導体パッケージにおける 金属 / 樹脂界面の評価 松尾圭一郎・久保 悠・山本哲也・田摩 京・池田 徹.....	240
	錫被覆銅を用いた導電性接着剤の Sn-3.0Ag-0.5Cu 架橋による伝導性向上 松嶋道也・谷山耕太郎・千田拓実・福本信次.....	246
	Sn-Bi 合金の変形挙動に及ぼす Bi 濃度の影響 山内 啓・黒瀬雅詞.....	253
報告記事	第 30 回エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術シンポジウム (Mate2024) 開催報告 岩田剛治.....	257
一般投稿		
研究論文	外部磁場を用いたティグ溶接の溶込み増加メカニズムに関する研究 松田昇一・棚原 靖・古免久弥・小林裕生・田中 学.....	261
会報・掲示板	N20

Journal of Smart Processing
Vol. 13 No. 5 2024 (September 2024)

CONTENTS

Special Issue on 30th Symposium on “Microjoining and Assembly Technology in Electronics” (Mate2024)

S.P.S. Announcement N19

Preface of Feature Article

Special Issue on “Mate2024”

Akira YAMAUCHI.....219

Feature Articles

Regular Research Articles

Development of an Extremely Small Power Chip Size Package

for Wide Bandgap Power Semiconductors and Its Evaluation and Analysis

Hiroki TAKAHASHI, Keita SUZUKI, Akira KITAMURA,

Tetsuo ENDOH and Yoshikazu TAKAHASHI.....220

Research on Thermal Resistance Reduction for High Heat Dissipation Microprocessor
with Chiplets

Koji NISHI.....226

Rough Copper Plating Surface on Lead Frame

by Using Periodic Reverse Pulse (PR Pulse) Electrolysis

Ryota NAKA, Junji YOSHIKAWA, Takao ISHIHARA and Kozo OONO.....233

Evaluation of Metal/Resin Interface in Semiconductor Packages Using the Method
of Predicting Delamination at Dissimilar Material Interfaces

Keiichiro MATSUO, Haruka KUBO, Tetsuya YAMAMOTO,

Kyo TANABIKI and Toru IKEDA.....240

Conductivity Improvement of Electrically Conductive Adhesive Using Tin-Coated Copper
with Sn-3.0Ag-0.5Cu Bridging

Michiya MATSUSHIMA, Kotaro TANIYAMA,

Takumi SENDA and Shinji FUKUMOTO.....246

Influence of Bi Concentration on the Deformation Behavior of Sn-Bi Alloys

Akira YAMAUCHI and Masashi KUROSE.....253

Special Report for Mate2024

Report on 30th Symposium on “Microjoining and Assembly Technology in Electronics”
(Mate2024)

Yoshiharu IWATA.....257

General Article

Regular Research Article

Study on Penetration Increase Mechanism of TIG Welding Using External Magnetic Field

Shoichi MATSUDA, Yasushi TANAHARA, Hisaya KOMEN,

Yuki KOBAYASHI and Manabu TANAKA.....261

S.P.S. News N20